

## 愛普科技股份有限公司

### 2025.05.06 法人說明會

#### 林郁昕 財務長

大家午安，我是愛普科技財務長林郁昕，歡迎各位投資先進參與愛普科技法人說明會，在會議的前段，我們將進行本公司 2025 年第一季的財務狀況及業務報告，簡報過後會進入問答階段，線上參與的投資朋友可於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆。

免責聲明的部分再請各位留意。

第 3 及第 4 頁是愛普科技的簡要資料，提供各位參考。

本次法說會會先由我來說明 2025 年第一季財務數字重點，洪志勳總經理將報告營運狀況以及未來展望，之後進行 Q&A，今日的與會團隊除了洪志勳總經理及我之外，陳文良董事長、薛澤源業務中心副總以及劉宗寧產品中心副總也會在線上回覆提問。

首先由我這邊進行財務狀況報告。首先說明 2025 年第一季的合併損益情形，愛普第一季合併營收金額為新台幣 9.7 億元，QoQ 減少 20%，主要是本季 VHM™及 S-SiCap™產品線單季出貨減少，YoY 則在 IoTRAM™ 需求回升下增加 30%。毛利金額為 4.5 億元，QoQ 減少 31%，YoY 增加 32%；第一季毛利率為 46%，QoQ 減少 7 個百分點，主要來自產品組合的不利變化，YoY 則維持相同。稍後總經理會有更詳細的說明。

本季營業費用為 2.8 億元，較去年第四季減少約 2,600 萬元，QoQ 減少 9%；較去年同期增加 3,700 萬元，YoY 增加 16%；營業費用的變動主要來自於研發費用的影響，本季研

發費用金額為 1.95 億元，季減 3,400 萬元，QoQ 減少 15%，年增 3,700 萬元，YoY 增加 23%。客戶專案相關的研發費用的認列跟 NRE 營收認列相關。本季認列的客戶專案 Milestone 比上季少，造成相應的研發費用也較上季減少。這是會計認列上的正常波動。

營業利益為 1.8 億元，受到營收及毛利率下滑的影響，QoQ 金額減少 50%；YoY 金額增加 66%則是來自於營收 YoY 上升的挹注。本季營業利益率為 18%，QoQ 因毛利率下降、營業費用率上升而下降 10 個百分點，YoY 增加 4 個百分點，主要是營業費用率下降。

公司業務有比較明顯的季節性，第一季通常是淡季。營業利益 YoY 比較能反映公司財務成績的表現。

業外收支的部分，第一季業外收入為 2.6 億元，主要來自於兌換利益 1.1 億元、利息收入 9,200 萬元、以及因投資標的估值增加帶來的金融資產評價利益 6,000 萬元的淨影響。金融資產評價利益在資產負債表的部分會有進一步的說明。

兌換利益來自於第一季底美元兌新台幣匯率升值 1.3%的影響，本公司有 2.5 億美元的資金部位，其中 1.8 億元來自於 GDR 募資資金。因本公司 GDR 募資資金除了研發投入之外，尚未大幅動撥，加上既有的外幣資金、應收付款等淨外幣部位，持續會受到匯率波動的影響，尚未動用的部位主要承作定期存款，美元利率區間約在 4 到 4.5%上下，每季可有 9 仟萬至 1 億元左右的利息收入，平衡可能的匯率波動；排除 GDR 相關兌換損益及所得稅影響數的擬制設算資料一樣會在下一頁做說明。本公司目前沒有採用外匯主動避險手段。主要的考量是美元和新台幣的利差已經提供了一部分的自然避險。此外，考量地緣政治風險，本

公司將持續進行集團資金的區域分散配置；同時我們也將擴展海外投資，董事會已經在 5 月 2 日同意擴大投資美國的研發中心，強化重要區域的營運佈局。

第一季稅前淨利為 4.3 億元，所得稅費用 8,900 萬元，排除第一季認列未分配盈餘稅額約 1,400 萬元的影響，所得稅有效稅率約為 17%。稅後淨利金額為 3.47 億元，其中歸屬於本公司業主的稅後淨利為 3.3 億元，QoQ、YoY 分別減少 34%及 10%，歸屬於本公司業主之稅後淨利率為 34%，單季每股盈餘為 2.04 元。

如果排除 GDR 未支用資金所產生的兌換損益，2025 年第一季業外淨收入為 1.8 億元，主要來自於利息收入 9,200 萬元、兌換利益 3,100 萬元及金融資產評價利益 6,000 萬元的淨影響數。排除 GDR 相關匯率影響後，第一季淨利金額將為 2.85 億元，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為 2.7 億元，QoQ 減少 20%，YoY 則增加 52%，歸屬於本公司業主之稅後淨利率為 28%。擬制調整後每股盈餘為 1.67 元。

合併資產負債表部分，季底總資產為 137 億元，較去年底增加 7.2 億元。其中，現金及約當現金為 51 億元、按攤銷後成本衡量之金融資產為 48 億元，總計金額為 99 億元，合計占總資產約 72%。按攤銷後成本衡量之金融資產是本公司承作之三個月以上定期存款。與去年底現金及按攤銷後成本衡量之金融資產這兩個科目合計數相較，淨增加約 9.7 億元，主要來自於營業活動應收帳款的回收、定存利息帶來的現金流入、合約負債預收的貨款、存出保證金到期返還及其他相對營業項目支出的現金流出互抵後的淨影響數。

第一季底應收帳款 5.4 億元，較去年底增加 1,800 萬元，收款天期維持在二個月內，整體應收帳款回收狀況良好。存貨金額為 11 億元，較去年底減少 9,000 萬元，下降 7%，目前庫存維持在 7 個月左右的合理水位，將持續依據接單狀況來動態管理。

本季底透過損益按公允價值衡量之金融資產增加約 1 億元，包括：海寧長盟公司投資估值提高約 6,000 萬元、本公司對美國新創公司 Power Lattice 追加投資金額約 4,000 萬元。

本公司自 3 月起在實質控制力認定下，將持股 28% 的 RFID 晶片設計公司—Onecent Technology 列入合併財務報表，採用權益法之投資金額因此相應減少。

年底的總負債為 24 億元，負債比率為 18%，較去年底增加 13.2 億元，主要為增加 11.4 億元的應付股利、合約負債增加 1 億元、以及應付所得稅增加 7,100 萬元的影響數。YoY 負債比率增加了一個百分點，主要是合約負債的增加。公司把客戶的預付款列為合約負債。

股東權益總金額為 113 億元，前面有提到，本公司對 Onecent 並非 100% 持股，因此權益項目在本季相對產生了非控制權益 1.8 億元，減除該項非控制權益後，屬於本公司業主之權益金額為 111 億元，因第一季決議盈餘分配現金股利 11.4 億元，因而較去年底權益淨值 119 億元減少，每股淨值為 68.49 元。

以上是就財務資訊的相關說明，接下來的時間由洪志勳總經理說明營運狀況，謝謝！

## 洪志勳 總經理

好的，謝謝財務長。各位投資先進大家好，接下來由我為大家報告第一季的營運狀況。

我們在上一季的法說會有和各位先進報告過，矽電容產品對公司業務的重要性越來越高。為了能向各位先進更清楚地呈現愛普在這幾個應用領域的表現，我們今年起會以 IoTRAM™、VHM™以及 S-SiCap™ 三個產品線的形式來分別向各位報告業績狀況。

首先，我們看營收與毛利，2025 年第一季的營收為 9.75 億元，相較前季減少了 20%，YoY 則增加 30%。

其中 IoTRAM™ 營收 8.55 億元，占營收的 88%，QoQ 減少了 2.7%；YoY 則是增加了 37%。VHM™ 產品線本季營收為 5,400 萬，占比 5.5%，QoQ 減少了 78%，YoY 減少了 36%，在 VHM™ 的 wafer sales 以及 IP Licensing 在本季都有減少。另外，在 S-SiCap™ 產品線的部分，本季營收 6,600 萬元，較前季減少了 36%，YoY 則增加了 65%，主要是因為 S-SiCap™ Interposer 產品陸續於去年下半年進入量產。針對各產品線的營運狀況，在稍後會進一步的說明。

本季的毛利率較前季下降了 7 個百分點，這主要是來自於產品組合的變化。其中高毛利的 VHM™ 營收減少貢獻了 5 個百分點是主要的原因，其他是 IoTRAM™ 以及 S-SiCap™ 的產品組合不利變化的影響。毛利率的部分會隨著產品組合的變化而波動。

接下來，我說明盈利的狀況。在這一頁上，左邊淺色的部分是營業利益，第一季的營業利益較前季減少了 50%，主要是因為本季營收較前季減少，以及第一季的獎金費用增加的因素，YoY 則是增加了 66%。營業利益率 18%，YoY 增加了四個百分點。公司的業務，特

別是 IoTRAM™的業務，呈現比較明顯的季節性因素的影響。YoY 的對比比較能夠呈現公司表現。

右手邊是業外收支，這部分主要來自於金融資產評價損益、外匯兌換損益和利息收入，本季為 2.6 億元，較前季減少了約一億元，剛才財務長有報告過，主要是匯兌利益的減少。業外收支這部分有比較多的不可控因素。

在第一季，總體淨利為 3.46 億元，較前季減少了 1.56 億，主要是第一季的營收較少較前季為低以及匯兌利益的影響，淨利率為 35%。

接下來我就三個產品線，在今年第一季的營運狀況分別為各位先進說明。

首先我們來看 IoT 產品線。

本季營收為 8.55 億元，QoQ 較前季減少了 3%。YoY 則是增加了 37%。

IoTRAM™的主要應用領域分為三塊，分別是：Connectivity、Wearable 及 Video/Audio/ Others 這三個部分。

Connectivity 的主要應用是通訊模組、Wi-Fi、Bluetooth 等。Connectivity 的應用在本季 IoTRAM™營收中占比約 52%。這部分營收較前季增加了 42%；較去年同期，增加了大約一倍，主要是通訊模組的需求較去年有所回升。我們之前向各位先進也報告過，通訊模組這個市場比較集中，競爭也比較激烈，毛利相對會比較低。通訊模組營收的增加對本季總體毛利率的影響大約是 1 個百分點。

在穿戴裝置的部分，本季金額較上季減少了 36%，主要是季節性的需求的影響，其中也包含了第四季客戶提前拉貨的影響。YoY 差不多持平。穿戴裝置在本季 IoTRAM™營收的

占比為 26%。

本季在 Video/ Audio/ Others 應用的營收，較前季減少約 10%，也主要是季節性因素的影響，YoY 差不多持平。這塊業務在本季 IoTRAM™ 營收占比為 22%。

IoTRAM™ 是我們最成熟的一個產品線，也是一直以來的營收主軸，我想在這裡進一步為各位說明。

穿戴裝置是一個蓬勃發展的一個應用市場。這個市場很重視使用者的體驗，有愈來愈多的各式裝置、規格也越複雜多樣，加上 AI(On-device AI) 功能的導入，對記憶體容量以及頻寬的需求也都在成長。隨著 Wearable 產品的多樣化以及各種新功能的導入，特別是 AI 功能的導入，使得銷量和單機記憶體容量同時提升，帶來很大的成長空間。

Connectivity 是一個很大的市場，價格競爭也非常激烈。儘管如此，客戶對愛普的產品仍是最有信心的。在這個市場，我們持續投入與客戶密切合作，推出更高性能、更好性價比的記憶體解決方案來提升客戶的產品競爭力，繼續提升我們的競爭優勢。

在 Display 的部分，客戶有看到我們 IoTRAM™ 相較於傳統 DRAM 不管是效能或是整體成本的優勢，有愈來愈多的客戶在新一代的產品採用 IoTRAM™。我們對於 IoTRAM™ 在這個應用領域的持續成長，深具信心。

另外，我們的 IoTRAM™ 在今年推出了一個新世代的規格，也就是 ApSRAM™。ApSRAM™ 提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足了客戶對效能的渴求，並且在功耗上面也降低了數倍，對穿戴裝置這類的追求高效能以及長待機的應用，ApSRAM™ 是最佳的解決方案。目前已經有許多的客戶採用，預計在明年會對營收有貢獻。

接下來我們來看 S-SiCap™。

S-SiCap™產品線的營收主要分為 IPC，也就是我們的矽電容中介層 (S-SiCap™ Interposer)，以及分離式的 S-SiCap™，我們叫做 IPD。

S-SiCap™產品線本季營收為 6,600 萬，較前季減少了 36%，這主要是因為本季 IPC 出貨較少；YoY 則成長了 65%。

IPC 從去年第三季開始進入量產，營收持續成長，第一季營收較前季低是由於客戶在量產的初期供應鏈產能波動的影響。目前我們看到客戶持續積極地下單，今年 IPC 營收會有逐季顯著的成長。

另外，在 IPD 的部分，嵌入 substrate 的應用目前在製程驗證試產的階段。本季營收較前季減少主要是因為客戶樣片在本季採購的量比較少的原因。

接下來，我想用這三張圖來說明我們 S-SiCap™在 2.5D 封裝的應用。

首先是矽中介層，也就是 Silicon Interposer，也就是以矽晶圓來作為中介層。這個用矽中介層的 2.5D 封裝技術，在業內經常被稱作是“COWOS-S”，應用於四個 Reticle Size 以下的晶片。由於 AI/HPC 耗能高、運算速度快，對 SI/PI 的要求也愈來愈嚴苛，矽中介層需要嵌入大量的電容。我們的解決方案是市場上少數符合客戶規格要求的產品，去年第三季已經進入量產，今年已經開始有顯著的營收貢獻，第二季開始將會有加速的 Ramp Up。

當 2.5D 封裝需要更大的面積的時候，molding-based interposer，就是如我們圖中左圖，中間的這個部分，也就是另一個選項。SoC 與其他的如記憶體等元件，以重佈線層 (Redistribution Layer, RDL) 來連接，再以封膠，也就是 molding 的方式來把它結合起來。這

種 molding-based interposer 的 2.5D 封裝經常被稱做 COWOS-L。這個封裝形式，需要整合更多的分離式電容，我們高電容密度的 IPD 就是非常適配的解決方案，目前還在開發當中。

另外，在第三種應用是嵌入封裝基板(embedded substrate)的應用，如左圖下。不管是 COWOS-S 還是 COWOS-L，未來都需要在基板中嵌入數十顆的 IPD。這個市場是非常大的。我們已經經營了一段時間，目前與客戶一起和多家的 Tier-1 的基板廠合作製程開發以及驗證，已經接近成熟，製程驗證預計在今年的年底、明年的年初會完成，量產開始後起量的速度則要看客戶的專案需求。

接下來，我們來看 VHM™ 產品線。

本季營收台幣 5,400 萬元，較前季減少了 78%，主要是因為礦機的 Wafer Sales 較前季減少。礦機 Wafer Sales 的減少是市場需求的因素。另外，本季 IP Licensing 認列的營收也減少，主要是因為落在本季認列的 Milestone 比較少。那 VHM™ 營收 YoY 減少了 36%。

我想利用這個機會向各位報告我們的 VHM™ 幾個階段。每一個階段都差不多是三年。

第一個階段是 VHM™ 產品架構的早期概念設計驗證。我們從 2018 年就開始進行 3D 記憶體開發。這個階段我們經營的重點是與早期採用客戶合作驗證 VHM™ 的效能，以及和業界合作 3D Memory 供應鏈生態系的建立。我們第一個採用 VHM™ 架構的產品是乙太礦機，以一片 Logic 再加上一片 Memory，也就是 1+1。我們順利的在 2021 年第二季進入量產，目前累計出貨約兩萬片。我們在礦機的市場證明了 VHM™ 的價值，利用比較成熟的製程，而且達到的效能大幅超過先進製程 GPU 的數倍。主流客戶也開始注意到了 VHM™，我

們開始與客戶討論 VHM™在 AI 以及 HPC 應用的導入。

從 2022 年開始，VHM™除了持續經營礦機市場以外，我們的主軸已經轉向與客戶討論 VHM™架構在主流應用 POC 專案的規格定義與執行。這個階段，除了 1+1 的 VHM™架構外，我們也開始與主流客戶進行多層堆疊的設計開發，也就是我們的 VHMStack™。這些專案在去年年底有接近有完成階段性的驗證，進一步加深了客戶對 VHM™以及 VHMStack™的信心，開始和我們進入量產產品討論的規格討論階段。

我們今年的重點專注在主流應用的產品實現，現在和客戶有幾個產品在規劃規格討論當中，預計今年會有設計定案，開始執行。產品開發到量產的時間，通常會需要兩到三年，我們預期在這些量產專案在進入量產之後，VHM™產品線將會有爆發性的成長。

另外，從市場的角度來看，過去因為 AI 軟體的迭代遠遠快於硬體的迭代，主流通用 GPU 繪圖晶片搭配 HBM 是 AI 訓練主要的一個硬體架構。自從生成式 AI 模型帶來的 AI 推論演算的需求爆發，我們發現越來越多客戶開始自研 ASIC 作為 AI 推論的運算核心，同時搭配 VHM™客製化 3D 記憶體達到系統效能功耗以及成本的整體優勢。這就像當初礦機晶片由 GPU 轉換成 ASIC 一樣，我們認為在 AI 推論這樣的趨勢已經開始，在類似的經濟推動力下，發展將會非常的快速。

以上是三個產品線在第四季的 Update。

整體來說，愛普今年延續去年下半年趨勢，今年在 S-SiCap™的 IPC 業績大幅成長，以及 IoTRAM™市場需求擴大的帶動下，我們預期業績會有顯著地增長。

VHM™產品線已經進入主流產品的設計導入階段，包括了單層以及多層的堆疊。有進

展我們會在每季的法說會向各位報告。

現在的整體經濟環境有很多的不確定性，其中包括了美國高科技的管制以及關稅戰，特別是匯率的變動風險，這都讓經營環境增添了許多的變數。我們一直與客戶保持密切溝通，以因應變化、滿足客戶的需求。另一方面，我們也擴大海外據點的經營，以降低經營風險。

以上是我的報告，謝謝。

## Q&A

謝謝總經理。本次的簡報到這裡告一個段落，接下來進入問答階段，請各位投資朋友於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆，謝謝。

**問題：請問目前對於 2025 年整體營運的預期？之前有提到會比去年好，現在的看法是否會因為美國關稅而有改變？**

**回答：洪志勳 總經理**

今年的營收較去年會有顯著地成長，那主要的結構性變化是 IPC 在整個需求增加，營收會有顯著地貢獻。另外，在關稅的影響的部分，我們現在沒有看到太明顯的影響。

**問題：第一季毛利率降低，請問公司對於後續毛利率的趨勢看法？方便提供三個產品線的預期毛利率區間嗎？**

**回答：洪志勳 總經理**

第一季毛利降低是因為產品組合的影響。那我們預期整體的毛利率區間會落在大概 40 到 50 之間上下，那隨著產品組合會有一些波動。那剛剛有問到，就是三個產品線預期的毛利區間，我想 VHM™ 會高於我們的平均，那 IoT 以及 S-SiCap™ 大概會在我們毛利預期區間的平均附近。

**問題：請問 2025 年各個產品線的營收走勢與占比？**

**回答：洪志勳 總經理**

在今年 IoT RAM™ 還是我們營收的一個主力，全年我們預期會占 6 成以上；S-SiCap™ 這部份成長快速，尤其是 IPC，有望超過兩成；那 VHM™ 則大概是在 1 到 2 成之間。

**問題：請教美國加徵關稅政策，對於愛普營運的影響程度？**

**回答：薛澤源 業務中心副總**

我們沒有直接出口美國的貨物，所以沒有直接的影響。而間接的影響，也就是我們的客戶出口美國的商品的部分，我們已經做了初步的盤點，會間接影響到營收的比例不大。

**問題：近期台幣升值劇烈，剛剛提到，公司帳上美金現金約有 2.5 億美元，這部分在台幣升值的環境下，公司有拿來做營運上使用？或是匯率上的避險？若沒有，公司內部有衡量大約有多少匯兌損失嗎？**

**回答：林郁昕 財務長**

公司在外匯管理的策略上考慮了美元相對臺幣的存款利率差。那這個 2 到 3% 的利率差是一種自然避險。我們目前是沒有在進行比較主動的匯率避險，所以當匯率有一些急劇變化的時候，無法避免我們帳面會有一定程度的損失。

那同時，我們公司已經有在做一些資金的調度，包含投資子公司，盡量來減少匯率帶來帳面上的損益波動。

**回答：陳文良 董事長**

這裡我補充一點，這個問題可能是這幾天大家比較關心的一個問題，在目前不確定的這個環境下面，我們認為我們現在比較大的外匯的這個部位是一個穩定性的因素，雖然短期會有一些匯兌的損失，但是中期或者長期是可以讓我們能夠承受更大的風險。

**問題：IoT RAM™ 這幾季的營收看起來都是持平，沒有什麼變動，是否意謂這塊的成長已經到頂了？或者有看到什麼增長的機會或是應用？**

**回答：劉宗寧 產品中心副總**

IoT 無所不在，再加上雲端上網和 AI 的功能之後，需要更多的記憶體容量和頻寬，整體來說，一定有持續性地成長。其中我們特別看好的就是穿戴裝置，包括智慧手錶和智慧眼鏡的市場發展。

**問題：請問 IoT 主要銷貨是在中國嗎？請問目前市場競爭情形？有降價壓力嗎？**

回答：薛澤源 業務中心副總

IoT 的部分，確實有 50% 以上的銷貨是在中國。那競爭跟降價的壓力其實是一直都有的。但我們的產品因為是客製化的原因，價格的波動其實並不會很劇烈。

**問題：請問總經理有提到第一季 VHM™ 產品出貨較少，請問怎麼看 2025 年出貨？跟 24 年相比會增加或減少？預計何時可以有礦機應用以外的量產出貨？**

回答：薛澤源 業務中心副總

VHM™ Wafer Sales 今年會比去年要來的少，那這個看法主要是基於我們對加密貨幣市場需求的判斷。那礦機以外的主流應用的量產，在今年還不會發生。

**問題：請問 Wafer-on-Wafer 的邏輯、DRAM 各是跟哪一家 Foundry 合作？堆疊是在邏輯還是 DRAM Foundry？使用的製程是？**

回答：洪志勳 總經理

目前力積電是我們的 DRAM 的 Foundry，邏輯 Foundry 和製程是由客戶來決定的，那當然也包括了台積電等第一線的大廠，而 Wafer-on-Wafer 的堆疊在力積電和邏輯 Foundries 都可以完成，我們也看到也更多的一線晶圓廠投入這方面的業務。

**問題：請問愛普在 SiCap 主要競爭者是誰？**

回答：劉宗寧 產品中心副總

愛普的 S-SiCap™ 主要是使用 DRAM 製程的堆疊式電容，其他的方案主要是採取邏輯製程的深溝式電容。目前在市場上看到的競爭者還不多，主要是因為市場才剛剛開始。愛普的堆疊式電容的優勢就是電容密度比深溝式電容更高，而且厚度可以更薄。

**問題：請問就 IPC/IPD 2.5D roadmap 來看，哪一塊會帶來比較大的營收貢獻？預計量產時點？**

**回答：薛澤源 業務中心副總**

IPC 去年底已經有客戶的產品開始進入量產，所以今年的營收貢獻會比較顯著。那 IPD 的客戶產品有機會在年底或明年初進入量產。長期來看，我們認為 IPD 的應用更廣，所以它的市場規模會更大。

**問題：請問 Interposer 主要合作的晶圓廠？使用的製程？以及主要技術門檻在？**

**回答：劉宗寧 产品中心副總**

我們的 IPC，也就是 Interposer with silicon Capacitor，是採用力積電的 DRAM 產線上的客製化製程。在製程技術方面，如何提供高的電容值和良率是主要關鍵。但是門檻不完全是製程技術而已。技術、應用和客戶服務的全面完美結合，才是真正的門檻。

**問題：請問 SiCap 的 IPD 第一季的營收減少，請問何時會再有營收？是 NRE 或是 Wafer 出貨？**

**回答：薛澤源 業務中心副總**

IPD 目前的出貨主要是嵌入基板應用製程開發所需要的樣片，所以出貨會比較不穩定。那剛剛有提到製程驗證會在今年底完成，但是量產拉貨的速度要看客戶專案的需求而定。

那這類的應用，主要還是在於客製化的 IPD，所以未來的營收中，NRE 與產品的銷售都會有。那產品的出貨也不一定是 Wafer 出貨。這個行業的客戶對於出貨的方式有比較特別的要求。

那 IPD 目前的產品出貨都還是樣品，那雖然量也不少，但是還不是像量產一樣，目前我們比較難預估。

**問題：多層堆疊的 VHMStack™現在可以疊到幾層？現有 DRAM 製程能夠符合客戶需求嗎？**

**回答：洪志勳 總經理**

我們目前正在開發堆疊八層的 DRAM，現有的 DRAM 製程可以滿足目前的客戶需求。但是，未來客戶主流產品需要的量只有 Tier-1 DRAM 廠商才有機會滿足。

**問題：請問第一季營收衰退是否有受到美國禁令的影響？**

**回答：薛澤源 業務中心副總**

剛剛報告中都有提到，我們第一季營收衰退主要是季節性的因素，禁令的影響不是個重要因素。

**問題：請問目前 VHM™ 除了 PoC 以外的產品專案的數量以及進度？**

**回答：陳文良 董事長**

客戶很多，最前沿的客戶已經基本上完成技術方案的討論。後面是一些商務討論和供應鏈的確認。

**問題：請問 VHM™、IPC、IPD 都是跟 AI/HPC 相關，可以分別說明一下主要的應用領域？**

**回答：陳文良 董事長**

VHM™主要是提供 AI 加速器和網路晶片所需要的高頻寬和低功耗的 Memory。IPC 和 IPD 則是提供高密度的電容給所有的高速運算和 AI 晶片，提供 SI/PI 的就是訊號品質跟電源品質的這個幫助。

**問題：PSMC 多次提到與愛普合作的 3D Stacking 為其發展重點，可以說明一下主要合作項目及合作方式？PSMC 是提供 DRAM 嗎？**

**回答：陳文良 董事長**

力積電是我們 DRAM 多層堆疊的主要供應商，也是業內 DRAM 多層堆疊最成熟的供應商。在力積電堆疊好的多層 DRAM 會送到邏輯晶圓廠做進一步的堆疊。

目前 POC 用的是力積電的 DRAM。也有一些量產客戶會繼續用力積電的 DRAM。但是未來主流應用的主流產品，也就是量非常大的產品，因為產能的原因，會採用 Tier-1 的 DRAM，但是也會在力積電堆疊，這個是我們 DRAM 多層堆疊生態的最基本的設計。

**問題：請問公司會執行庫藏股嗎？**

**回答：陳文良 董事長**

公司董事會就這個議題有做過討論，結論是暫時不做。

問題：公司有提到要增加在美國研發中心的投資，可否再詳細說明一下？會動用到 GDR 的資金嗎？

回答：陳文良 董事長

美國是 HPC 最大、最重要的市場。我們的 HPC 客戶也大多數在美國。我們在美國擴大研發和業務團隊的規模，就是更好的就地服務美國的客戶。這部分確實會使用 GDR 的資金。

問題：請問公司目前與其他記憶體代工廠合作的進度？

回答：洪志勳 總經理

我們目前有一些進展，那具體的細節現在還不方便向各位先進透露，謝謝。

問題：與新創公司合作的 UHF RFID 標籤 IC 預計會在今年開始量產，請問進度不變嗎？是 for 大陸市場嗎？

回答：陳文良 董事長

我們現在 UHF RFID 的開發進度不變，我們還是預計今年會量產。市場是全球的，不只是大陸。

問題：前次法說會提到公司正集中精力做 AI/HPC 量產產品的 Design-in，如果順利，有機會在今年完成第一個 AI/HPC 的產品設計，請問進度為何？順利進行中嗎？

回答：洪志勳 總經理

我剛剛在報告裡面有提到，VHM™在 AI/HPC 量產產品，現在正在有一些 Design-in 的討論，那我們是預計會有案子在今年會有設計定案，然後開始執行，那現在進度看起來是很順利的，謝謝。

問題：今年股東會上陳董提到應用於 2.5D 先進封裝製程的 Interposer 產品目前供不應求，所以這一塊對公司今年的營收貢獻能有多少？

回答：薛澤源 業務中心副總

前面都有報告過，Interposer 的營收較去年會有顯著的成長。

**問題：將 VHM™技術與來頡產品結合的進度為何？若順利開發成功將會是在哪一個領域發揮？**

**回答：陳文良 董事長**

這個合作還在規劃跟討論當中。應用的領域是和 VHM™應用相關的 PMIC。

**問題：目前公司的三大產品的各項表現越來越好，目前能見度在未來三季都能逐季成長，可以請問 AI 事業部，目前的階段可以用正在賽道的起跑點準備衝刺來形容嗎？**

**回答：陳文良 董事長**

我們學理工的不太會形容。不過我們今年三個產品線的大致狀況概括一下是這樣：IoT 會穩步成長；S-SiCap™ 會快速成長；VHM™在客戶上的 Design-In 這邊有大大地進展，但是今年對營收的貢獻還不會有顯著地成長。

**問題：請問目前 VHM™礦機主要是用在以太經典幣，此小眾幣種對營收貢獻有限。請問公司是否有開發比特幣等主流幣種礦機的規劃？**

**回答：陳文良 董事長**

這個主要是一個算法上的差別，比特幣沒有用 Memory，所以我們沒有辦法

**問題：請問 VHM™記憶體容量可以到達多少？可否將各目標市場所需的容量說明一下**

**回答：陳文良 董事長**

VHM™的容量範圍可以很大，大到幾十個 GB，那我們目前客戶提出來的要求，大概也就是在這個範圍，大於這個的、幾百 GB 的，目前沒有要用 VHM™。所以這一塊我們客戶提的要求，我們都會想辦法做到。

謝謝各位先進的提問，問答階段在此告一個段落，會後若有其他問題，各位可聯繫本公司 IR 團隊。

謝謝各位的參與，今天的會議到此結束，謝謝！

## 聲明

若逐字稿內容與法說會現場陳述內容有不一致之處，應以法說會現場陳述內容為準。

上述訊息所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性，任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況。

上述訊息中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。